

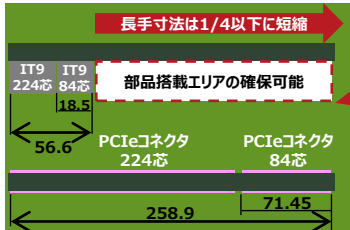
特長

- 1 高速伝送対応(32+Gbps対応)
- 2 高密度 : 50差動ペア/インチ (224芯)
- 3 フローティング構造により同一基板に複数実装可能
- 4 バリエーション
・芯数 : 84芯、152芯、224芯

PCI Express
4.0/5.0対応

高密度実装

カードエッジコネクタとの実装面積比較



高密度実装のため、
長手寸法は
1/4以下に短縮。
部品搭載可能エリア
が増加

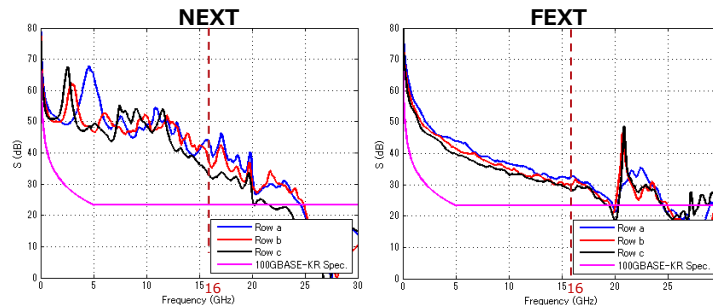
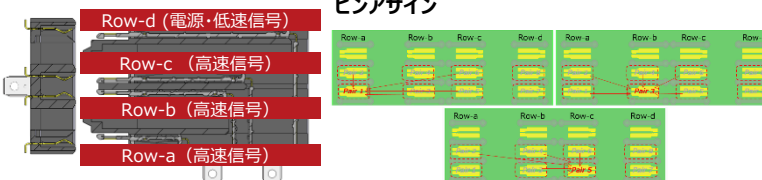
ご使用例

オプションボード



32+Gbps対応/SI特性

ピンアサイン



仕様

定格電流	0.3A (差動信号ブレード) 0.5A (電源/低速信号ブレード)
定格電圧	50V AC/DC
使用温度範囲*1	-55 ~ +85°C
接触抵抗*2	Row-a : 60mΩ 以下 Row-b : 70mΩ 以下 Row-c : 80mΩ 以下 Row-d : 90mΩ 以下
耐電圧	150V ACで1分間
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (100V DC)
挿抜回数	100回

*1 通電による温度上昇を含む
*2 導体抵抗を含む

IEEE802.3apの規格において、十分なマージンを有しております